

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年1月26日 (26.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/009076 A1(51) 国際特許分類⁷: G03F 7/11, C08F 299/02, G03F 7/004, 7/027, 7/031, 7/033, H05K 3/06, 3/18

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/013053

(22) 国際出願日: 2005年7月14日 (14.07.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-212227 2004年7月20日 (20.07.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 久保田 雅夫 (KUBOTA, Masao) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目1番1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 吉廻 公博 (YOSHIZAKO, Kimihiro) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目1番1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 高野 真次 (TAKANO, Shinji) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目1番1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 磯 純一 (ISO, Junichi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目1番1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

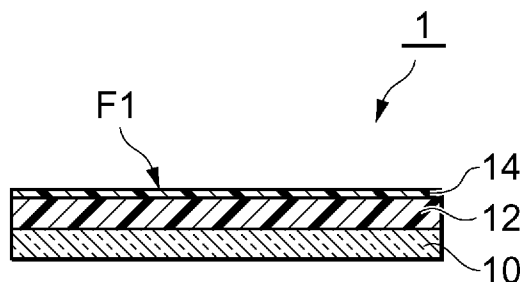
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOTSENSITIVE ELEMENT, METHOD OF FORMING RESIST PATTERN WITH THE SAME, AND PROCESS FOR PRODUCING PRINTED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 感光性エレメント、これを用いたレジストパターンの形成方法及びプリント配線板の製造方法



unsaturated bond per molecule and a second photopolymerization initiator.

(57) Abstract: A photosensitive element which comprises a support film (10), a cushioning layer (12) formed on the support film (10), and a photosensitive layer (14) having a thickness of 10 μm or smaller formed on the cushioning layer (12), characterized in that the photosensitive layer (14) is a layer comprising a binder polymer having a weight-average molecular weight of 10,000-100,000, a first photopolymerizable compound having at least one polymerizable, ethylenically unsaturated bond per molecule, and a first photopolymerization initiator and the cushioning layer (12) is a layer comprising a second photopolymerizable compound having at least one polymerizable, ethylenically

(57) 要約: 本発明の感光性エレメントは、支持フィルム10と、該支持フィルム10上に形成されたクッション層12と、該クッション層12上に形成された厚みが10 μm以下の感光層14と、を備え、前記感光層14は、10,000~100,000の重量平均分子量を有するバインダポリマーと、分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する第1の光重合性化合物と、第1の光重合開始剤と、を含有してなる層であり、前記クッション層12は、分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する第2の光重合性化合物及び第2の光重合開始剤を含有してなる層であることを特徴とするものである。

WO 2006/009076 A1